

## H200 常规系列

# 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

### 应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

#### 储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

#### 保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

### 产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	浅蓝色	---	目视
厚 度	0.3~18	mm	ASTM D 374
硬 度	10~55( $\pm 5$ )	Shore C	ASTM D 2240
密 度	2.8 $\pm$ 0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	$\geq 0.25$	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	$\geq 70$	%	ASTM D 412
压 缩 比	$\geq 25$ (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

### 热学特性

导热系数	2.0 $\pm$ 0.2	W/m $\cdot$ K	ASTM D 5470
热 阻	$\leq 1.2$ (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

### 电学特性

击穿电压	$\geq 8$	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	$\geq 2$	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	$\leq 0.1$	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权